

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	东方财富证券：梅宇鑫、岳高岩、柳西仇；益安资本：李亚军； 上海天倚道投资：周江；锦泓基金：杨镇宇；一犁基金：李阳； 临平渥能：宁九云；上海景行投资：俞浩；上海雷菱投资：于艺； 上海智晶投资：薛伟杰；上海简帧投资：苏文天。
时间	2025年7月22日 14:30—16:00
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛；投资者关系专员：安琪
投资者关系活动主要内容介绍	<p>董事会秘书沈一涛对公司的业务状况展开了详细介绍，同时也对公司的未来发展做了概要介绍。</p> <p>Q1:请介绍一下公司在风电叶片材料领域的市场发展态势与竞争优势？</p> <p>A:作为胶粘剂板块营业收入的主要来源之一，公司已形成风电结构胶、环氧灌注树脂、拉挤树脂、喷胶、丁基胶条及主梁拉挤板复合材料等风电叶片材料全链条供应体系。2024年，风电环氧结构胶、灌注树脂等各类产品销售总量近9万吨；2025年一季度，风电结构胶销售量继续保持市占率领先地位。“十四五”规划收官之年，风电作为清洁能源的重要组成部分，发展趋势向好。而公司作为国内早期通过国际风能权威机构德国劳埃德船级社（GL）认证之一的企业，在风电叶片胶粘剂市场中深耕多年，产品可应用于百米级叶片，满足不同叶型需求。随着叶片大型化的趋势，公司先进的生产技术和工艺、快速响应的客户服务、高性价比的产品优势在促进公司发展、改善产品质量、保持</p>

	<p>核心竞争优势等方面起着重要的作用。</p> <p>Q2: 请介绍一下公司在研发领域的主要攻关方向及投入强度?</p> <p>A:公司在研发领域聚焦三大核心方向并加大投入力度：在胶粘剂与特种树脂新材料领域集中资源解决现有产品的技术难点，同时强化技术研发、工艺技术管理的规范性，实现了为客户提供稳定品质产品的能力，推动风电叶片材料技术升级并拓展其他胶粘剂产品性能提升与应用；在电子信息材料领域，主攻高端国产替代技术，覆盖大尺寸 ITO 靶材、CMP 抛光液及 LTCC 材料体系等关键领域；在电子科技领域，深耕电子技术研发，开发相关核心产品并拓展其在多领域的应用。</p> <p>研发投入方面，2024 年公司研发费用达 2.04 亿元，占营业收入的 6.56%；研发团队规模为 376 人，占员工总数的 22.97%。目前，ITO 靶材项目已进入试生产状态、CMP 抛光液中试项目已进入内部测试阶段。</p> <p>Q3: 请介绍一下公司拟收购标的成都中科华微及收购进展情况?</p> <p>A:成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”）是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线，包括微控制器芯片 MCU 和 SOC（32 位微型控制器电路、16 位微控制器电路、8 位微控制器电路等）、系统级 SIP 芯片（射频综合控制 SIP 芯片、数据处理模块、异构处理器 SIP 芯片）、各类模拟集成电路（电源管理、接口电路、信号链电路等）以及电路模块等系列产品，尤其在特种装备 MCU 国产替代细分领域具有技术优势和市场影响力。中科华微被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获评四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心，相关领域资质齐全。</p> <p>截至目前，本次交易的审计、评估等各项工作正在有序推进中。</p> <p>Q4: 请介绍一下 CMP 抛光液等半导体材料的布局思路以及未来在半导体领域的中长期规划?</p> <p>A: 公司将以现有半导体材料产业（包括 CMP 抛光液、溅射靶材、陶瓷材料等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体产业战略转型升级。公司依托前期布局，立足“硬科技”，着力构建涵盖集成电路设计、制造及封装测试的产业链条。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 7 月 23 日